

平成 27 年 12 月 2 日

一般社団法人日本金型工業会
西部支部長 堀口 展男

■2月勉強会

第4回金型関連技術発表講演会開催のご案内

好評により毎年開催決定これまで無かった関西発の金型技術情報

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃は日本金型工業会の活動に格別のご理解ご協力賜り厚く御礼申し上げます。
さて、西部支部主催**第4回金型関連技術発表講演会**を**2月18日(木)**に開催致します。
万障お繰り合わせの上ご出席のほどお願い申し上げます。

なお準備の都合がございますので、別紙の参加申込書に必要事項をご記入の上、1月25日(月)までに、事務局にメール k.yoshida@jdmia.or.jp か FAX 06-6479-1479 でご返信のほどお願い申し上げます。

敬具

記

日 時 平成28年2月18日(木) 午後1時30分～午後5時55分
午後6時15分～懇親会

場 所 発表講演会
大阪科学技術センタービル 8階小ホール
大阪府大阪市西区靱本町1-8-4 【別紙案内図参照】
懇親会場(未定 本町駅付近)

基調講演テーマ 「大学で行ってきた金型を使った部品、製品開発事例紹介」

講演者名 東京工科大学 名誉教授 福井雅彦 氏

参加費 発表講演会 会員 (一般社団法人日本金型工業会会員) 無料
会員外 1日無料会員体験対象事業なので 無料
懇親会 6,000円(当日領収書をお渡しします)

参加申込み方法 別紙参加申込書を1月25日までにFAXでお送り下さい
FAX 06-6479-1479

定 員 70名(定員に達し次第締め切らせていただきます。ご理解の程何卒よろしく
お願い申し上げます。)

問い合わせ先・申込先

一般社団法人日本金型工業会西部支部

〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1-8-4 大阪科学技術センタービル305
電話 06-6479-1477 FAX 06-6479-1479

以上

当日の発表内容

プログラム①

テーマ「**教材用透明アクリル金型の特徴と適用事例**」

サブタイトル「**ものづくりの基本、だから金型をもう一度考える**」 **CLEAR MOLD**

会社名：株式会社サン精機

発表者：代表取締役社長 楠牟禮 勲 氏

発表内容

「ものづくりの基本、だからもう一度考える」をコンセプトに、金型が成形機の中でどのような仕組みで動いているのかを容易に確認できるように、視覚的要素を加えた透明アクリル製の教材金型「**CLEARMOLD**」を製造販売。その開発経緯・特徴・活用事例などを発表する。

昨年より日本金型工業会のブース枠内においてインターモールドに出展。

開発には「ものづくり補助金」を活用。

プログラム②

テーマ「**～ジェイコア～ 加工段差ゼロを目指して**」

会社名：日工機械株式会社

発表者：営業部 課長 村井 隆 氏

発表内容

「ジェイコア」はマシニングセンタの限界性能を引き出す、超精密撮影式工具測定機です。

加工回転数で計測した、工具先端の座標と振れを含めた動的工具外径を加工に反映させる事で限りなく狙い値に近い高精度な加工を実現する事が可能です。

プログラム③

テーマ「**樹脂流動解析における電磁誘導急速加熱解析と実際の運用事例**」

会社名/発表者：株式会社 CAEソリューションズ 技術サポート事業部 大桑 一 氏
株式会社ロックツールジャパン 代表 神谷 毅 氏

発表内容

近年、金型の温度制御による外観品質の向上や成形サイクルの最適化などが盛んに行われています。ヒート&クールや急速加熱冷却などと言われ、用いられる手法も様々です。本発表では、その中でも最新の手法電磁誘導加熱冷却を如何に実金型に用いるか、また金型設計時の支援となる CAE 技術はどのように使えるかなどを開発メーカーである(株)ロックツール社様との共同報告いたします。

プログラム④

テーマ「**ISID が推進する金型設計製造領域での 3D 活用**」

会社名：株式会社 電通国際情報サービス

発表者：エンジニアリングソリューション事業部 CS 部 高木 宏孝 氏

発表内容

金型製造領域において CAD/CAM/CAE などの IT ツールが広く使われていますが、作業領域の効率化にとどまっているケースが多いと思われます。

今後はさらに、熟練者によるノウハウの領域にも活用することが重要になります。 ISID が注力しているテーマは「金型製造全体での 3D 活用」です。具体的には、次のような取り組みを行っております。

①金型設計前に製品形状を自社製品「生産要件チェッカー」で検証し、製品設計形状から判定するしくみにより、製造難易度や見積もり情報を見出す取り組みをしています。

②自社製品「Mold Planner」で、金型構想検討段階で活用する形状分析機能の開発・強化に力を入れ

ています。例としては、金型難易度の評価、離型性評価、熱だまり評価等です。

③型 CAE(樹脂流動/金型強度/機構解析等)を積極活用して、解析ツールと最適化ツールと組み合わせて候補案の決定をするなど、高度な検討できるようなソリューションを研究開発中です

④実測データの収集では、機上測定、接触式3次元測定へのデータ出力と検証を、統一フォーマットで加工評価・製品評価が可能です。

品質向上・コスト低減・期間短縮に繋げられるのかに関して、金型設計・部品加工・計測の領域でNXによる一気通貫した3D活用のサイクルの事例を紹介します。

プログラム⑤

テーマ「マシニングセンタによるジグ研削加工」

会社名：株式会社牧野フライス製作所

発表者：粕谷 建司 氏

発表内容

マシニングセンタによる焼入ダイプレートの自動加工システムを開発致しました。熟練を要するジグ研削工程をマシニングセンタに集約する最新技術をご紹介します。

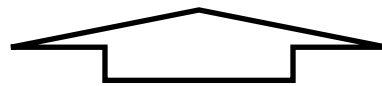
プログラム⑥ 基調講演

講演テーマ「大学で行ってきた金型を使った部品、製品開発事例紹介」

講演者： 東京工科大学 名誉教授 福井雅彦 氏

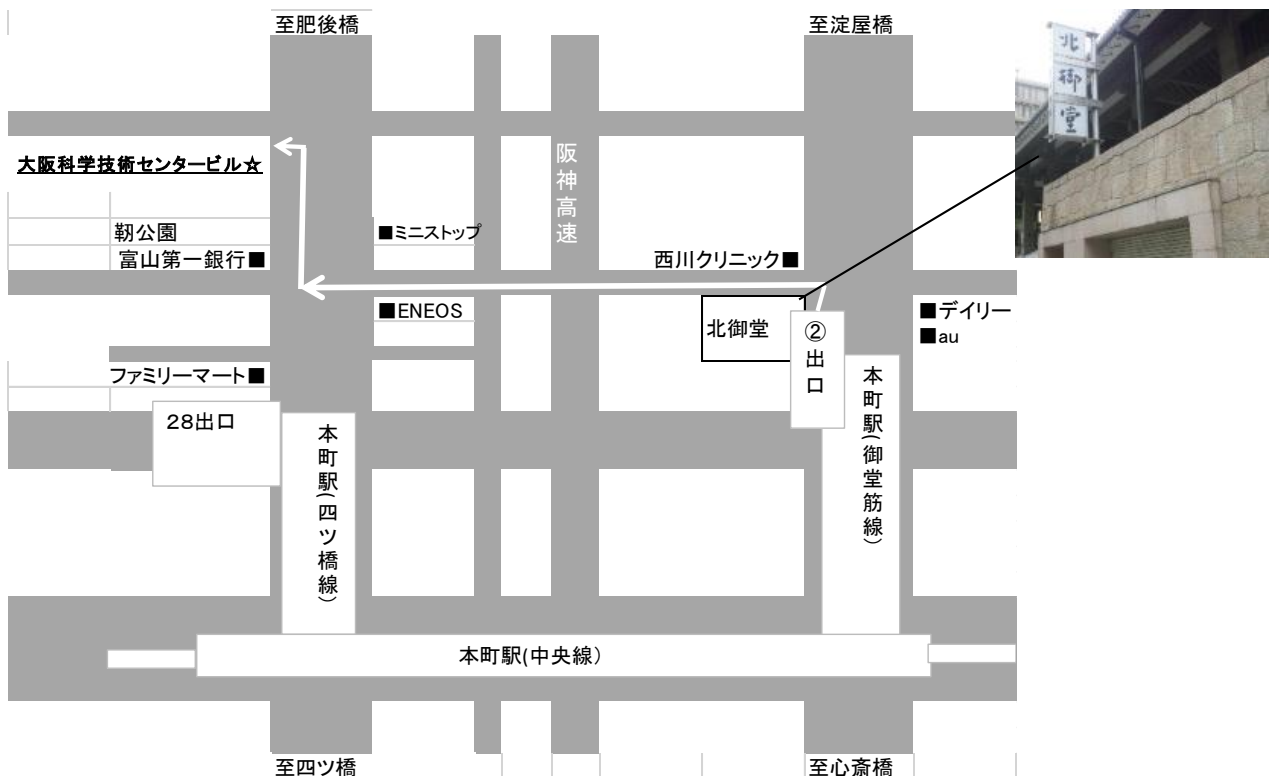
講演要旨

金型業界の現状を紹介した後、産業界の要請を受け開発を行ってきた金型加工技術、金型製作に加え金型を用いた成形技術について事例で紹介する。金型加工技術では、加工工法、CAD/CAMの内容、工具が加工結果にどのような影響を及ぼすか事例を交え紹介する。例えば、加工工法が加工結果にどのような影響を及ぼすかやCAD/CAMの内容が加工結果に及ぼす影響などを光学機器部品金型（ホール加工）、ダイカスト金型（磨きレス加工）、閉塞鍛造金型（超合金金型の直彫り）など加工事例を紹介する。金型を用いた成形技術では、抜き勾配なしダイカスト成形（マグネ、アルミダイカスト）、厚板の精密せん断（自動車部品）、高張力鋼板のプレス成形（センターピラーなど）などについて開発事例を紹介する。



第4回金型関連技術発表会
参加申込書
(FAX 06-6479-1479)

会社名		
お役職/部署名		() 講演会 (無料)
お名前		() 懇親会 (6,000円)
お役職/部署名		() 講演会 (無料)
お名前		() 懇親会 (6,000円)
電話番号/FAX	電話	FAX
メールアドレス		



大阪科学技術センタービル (OSTEC) 〒550-0004 大阪市西区鞆本町1-8-4

地下鉄四つ橋線「本町駅」28番出口より北へ徒歩3分

地下鉄御堂筋線「本町駅」2番出口より西へ徒歩7分

「大阪科学技術館」の看板が目印です。そちらにお入り下さい。

駐車場がございませんので、公共交通機関をご利用下さいます様お願い申し上げます。